

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/09/2024 | Edição: 173 | Seção: 1 | Página: 35

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI Nº 73, DE 16 DE AGOSTO DE 2024

Altera o Processo Produtivo Básico - PPB para APARELHO TELEFÔNICO POR FIO CONJUGADO COM APARELHO TELEFÔNICO PORTÁTIL SEM FIO, QUE INCORPORE CONTROLE POR TÉCNICAS DIGITAIS, industrializado na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, art. 4º e nos arts. 11 a 18 do Decreto nº 10.521, de 15 de outubro de 2020, e considerando o que consta no processo nº 19687.000327/2024-13, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto APARELHO TELEFÔNICO POR FIO CONJUGADO COM APARELHO TELEFÔNICO PORTÁTIL SEM FIO, QUE INCORPORE CONTROLE POR TÉCNICAS DIGITAIS, industrializado na Zona Franca de Manaus, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto no Anexo desta portaria, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo 366 (trezentos e sessenta e seis) pontos por ano-calendário.

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo desta portaria só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo desta Portaria deverá ser aplicado, na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização com fruição do benefício fiscal, do produto a que se refere esta Portaria, deduzidos os tributos incidentes nesta operação.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º Fica revogado a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 174, de 03 de outubro de 2007.



Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO

Etapas	Descrição da etapa produtiva	Pontos Totais
I	Projeto e desenvolvimento no país - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018 ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	112
II	Investimento adicional em PD&IA, valendo 10 pontos para cada 1% investido adicionalmente em PD&IA, limitado a um máximo de 40 pontos.	40
III	Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware).	10
IV	Injeção, moldagem, impressão 3D, ou outro processo de conformação plástica da Base e Portátil.	65
V	Injeção, moldagem, impressão 3D, ou outro processo de conformação plástica do conversor CA/CC.	29
VI	Fabricação dos capacitores a partir do encapsulamento.	131
VII	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso da base.	75
VIII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso da Base.	69
IX	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso do Portátil.	106
X	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso do Portátil.	75
XI	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso do conversor CA/CC.	24
XII	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de conversor CA/CC.	68
XIII	Montagem do cabo de força do conversor CA/CC a partir do corte do cabo, a decapagem, estanhagem, crimpagem ou soldagem dos conectores ou plugues de tomada, quando aplicável.	18
XIV	Corte, laminação e montagem do circuito flexível com tinta condutiva para formação da membrana condutiva do teclado.	56
XV	Laminação e corte das placas de vidro e encapsulamento das células de vidro polarizado da tela de cristal líquido (LCD).	119
XVI	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso do módulo transceptor, quando não integrada à placa principal.	28
XVII	Empilhamento ou montagem dos eletrodos, inserção do eletrólito, encapsulamento da célula da bateria em invólucro e vedação hermética.	71
XVIII	Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação final do produto.	30
XIX	Testes.	30
	Total	1.156
	Meta	366



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.